

美國白宮發布《晶片與科學法》實施一周年總結



美國白宮（The White House，以下簡稱白宮）於2023年8月9日發布《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act，以下簡稱晶片法）頒布一周年之總結，說明相關補助及租稅優惠措施之實施成效。自晶片法施行以來，已吸引高達1,660億美元之私人投資，並有50所以上大學宣布將開設半導體人力培訓課程，顯示晶片法對半導體生產製造在地化已有相當成效。晶片法施行後推動之措施如下：

1. 說明半導體補助申請流程及條件

美國國家標準及技術研究院（National Institute of Standards and Technology）於2023年2月28日分別發布「半導體製造補助之申請指引」（Funding Opportunity—Commercial Fabrication Facilities）與「半導體製造補助願景」（Vision for Success: Commercial Fabrication Facilities），說明晶片法補助目的、申請流程、條件以及注意事項，並於同年6月23日更新相關內容。

2. 說明柵欄條款之運作方式

美國商務部（Department of Commerce）與財政部（Department of Treasury）2023年3月23日於美國聯邦公報（Federal Register）發布法規預告（proposed rules），詳細說明晶片法內柵欄條款（guardrails）之運作方式。根據法規預告之內容，受補助人於受補助後的10年內若未經美國商務部與財政部同意，不得於中國等特定國家進行半導體製造設施「實質擴廠」之「重大交易」，避免受補助人將晶片法提供之補助用於中國，進而侵害美國國家安全。

3. 強化半導體研發創新

美國商務部於2022年9月6日發布「美國晶片補助戰略」（A Strategy for the CHIPS for America Fund），說明商務部將與國家科學基金會（National Science Foundation）等建立「國家半導體科技中心與執行國家先進封裝製造計畫」（National Advanced Packaging Manufacturing Program），協助美國維持半導體研發之領先地位，並大幅縮短研發成果商用化之時程。

4. 保障區域經濟發展與創新

美國商務部於2023年5月發布第1期「科技中心計畫」（Tech Hubs Program）申請指引，協助區域製造、商業化和部署關鍵技術；並於2023年6月發布第1期「重新競爭領航計畫」（Recompete Pilot Program），為長期處於經濟困境的美國社區提供就業機會。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

- [THE WHITE HOUSE, FACT SHEET: One Year after the CHIPS and Science Act, Biden- Harris Administration Marks Historic Progress in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Supporting Innovation, and Protecting National Security \(Aug. 09, 2023\)](#)
- [NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, CHIPS Incentives Program – Commercial Fabrication Facilities \(June 23, 2023\)](#)
- [Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding, 88 Fed. Reg. 17,439-450 \(Mar. 23, 2023\) \(to be codified at 15 C.F.R. pt. 231\)](#)
- [Advanced Manufacturing Investment Credit, 88 Fed. Reg. 17,451-466 \(Mar. 23, 2023\) \(to be codified at 26 C.F.R. pt. 1\)](#)
- [Elective Payment of Advanced Manufacturing Investment Credit, 88 Fed. Reg. 40123-133 \(June 21, 2023\) \(to be codified at 26 C.F.R. pt. 1\)](#)

- 2023 LINE PROTOSTAR 新星創業營-五月場（實體參與報名）
- 2023 LINE PROTOSTAR 新星創業營-五月場（線上參與報名）
- 【2023科技法制變革論壇】 高齡科技發展與法制策略論壇
- 供應鏈資安國際法制與政策趨勢分享會
- 新創採購-政府新創應用分享會
- 智慧港灣/休憩/育樂面面觀-跨界在地合作新商機

吳彬諳

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2023年09月

資料來源：

THE WHITE HOUSE, *FACT SHEET: One Year after the CHIPS and Science Act, Biden- Harris Administration Marks Historic Progress in Bringing Semiconductor Supply Chains Home, Supporting Innovation, and Protecting National Security* (Aug. 09, 2023), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/08/09/fact-sheet-one-year-after-the-chips-and-science-act-biden-harris-administration-marks-historic-progress-in-bringing-semiconductor-supply-chains-home-supporting-innovation-and-protecting-national-s/> (last visited Sep. 05, 2023).

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, *CHIPS Incentives Program – Commercial Fabrication Facilities* (June 23, 2023), <https://www.nist.gov/system/files/documents/2023/06/23/CHIPS-CFF%20NOFO%20Amendment%201%20Redline.pdf> (last visited July 10, 2023).

Preventing the Improper Use of CHIPS Act Funding, 88 Fed. Reg. 17,439-450 (Mar. 23, 2023) (to be codified at 15 C.F.R. pt. 231), *available at* <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-23/pdf/2023-05869.pdf> (last visited Sep. 05, 2023).

Advanced Manufacturing Investment Credit, 88 Fed. Reg. 17,451-466 (Mar. 23, 2023) (to be codified at 26 C.F.R. pt. 1), *available at* <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-03-23/pdf/2023-05871.pdf> (last visited Sep. 05, 2023).

Elective Payment of Advanced Manufacturing Investment Credit, 88 Fed. Reg. 40123-133 (June 21, 2023) (to be codified at 26 C.F.R. pt. 1), *available at* <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-06-21/pdf/2023-12800.pdf> (last visited Sep. 05, 2023).

延伸閱讀：

趙奕縣，〈美國簽署晶片和科技法案，全球科技業將掀起波瀾〉，資策會科法所，2022/09，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8879&no=64>（最後瀏覽日：2023/09/05）。

文章標籤

公私協力

產學研合作

半導體

美中科技戰

 推薦文章